

2008年3月期中間決算補足資料 (2007年11月)



Challenge 30

誇りあるTOWAブランド確立に向けて!

2008年3月期中間決算
会社説明会

2007年11月

TOWA株式会社

1

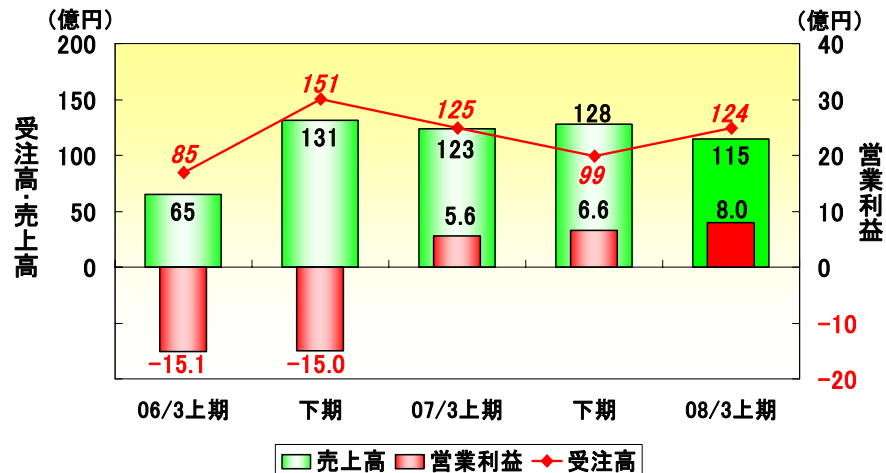
中間期業績概要(連結)

(百万円)

	予想	実績	前年同期	増減額	増減率
受注高	12,000	12,443	12,479	-36	-0.3%
売上高	11,500	11,460	12,346	-885	-7.2%
営業利益	750	803	559	+243	+43.6%
経常利益	700	824	528	+295	+56.0%
当期純利益	700	885	400	+485	+121.5%

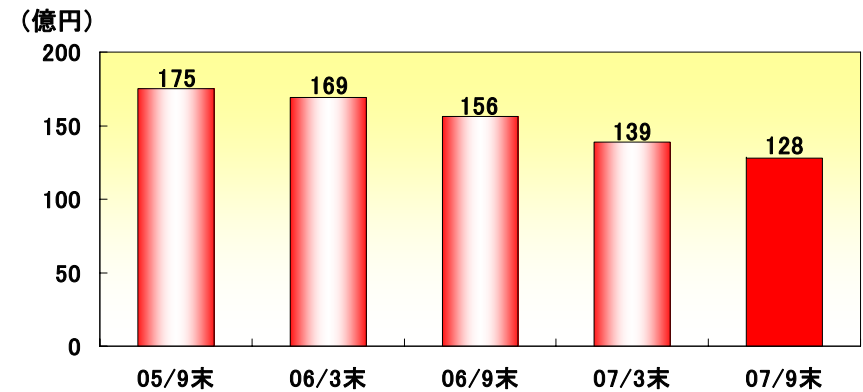
2

受注高・売上高・営業利益推移(連結)



3

借入金残高推移(連結)



4

通期業績予想(連結)

(百万円)

	上期	下期	通期	前期比増減率
受注高	12,443	14,557	27,000	+20.6%
売上高	11,460	14,540	26,000	+3.3%
営業利益	803	1,097	1,900	+55.2%
経常利益	824	976	1,800	+39.6%
当期純利益	885	915	1,800	+73.3%

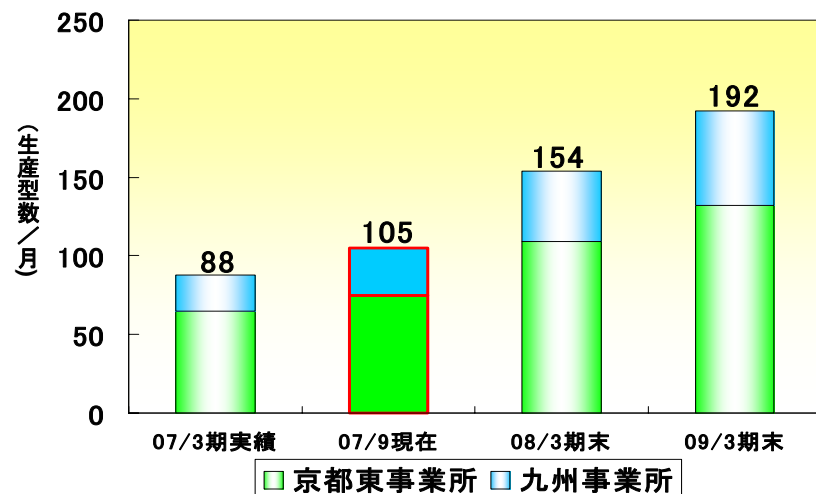
2008年3月期 最重点戦略

➤シェアアップ(50%超)

•金型の生産キャパアップ

•短納期

金型の生産能力強化



TOWAM工場の生産能力拡大



<増築前>



<増築後>

(床面積) 4,459㎡

7,431㎡

(組立能力)

モールド装置 13台/月

22台/月

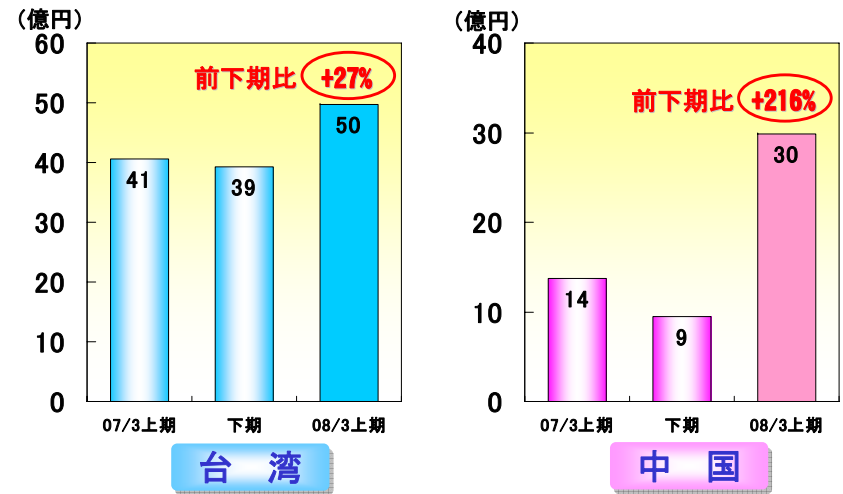
シンギュレーション装置 4台/月

8台/月

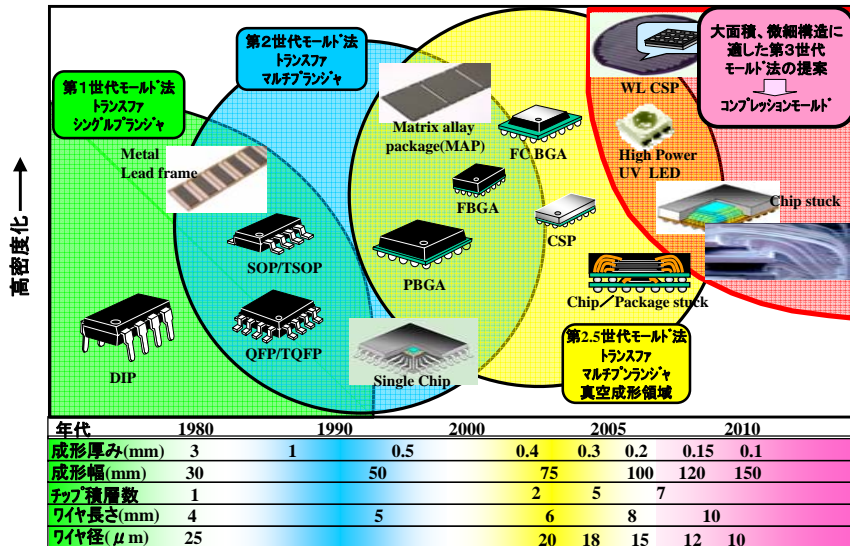
市場環境

- ▶台湾アセンブリハウスの中国進出本格化
- ▶コンプレッションモールドの進展
- ▶高輝度LEDの量産化スタート

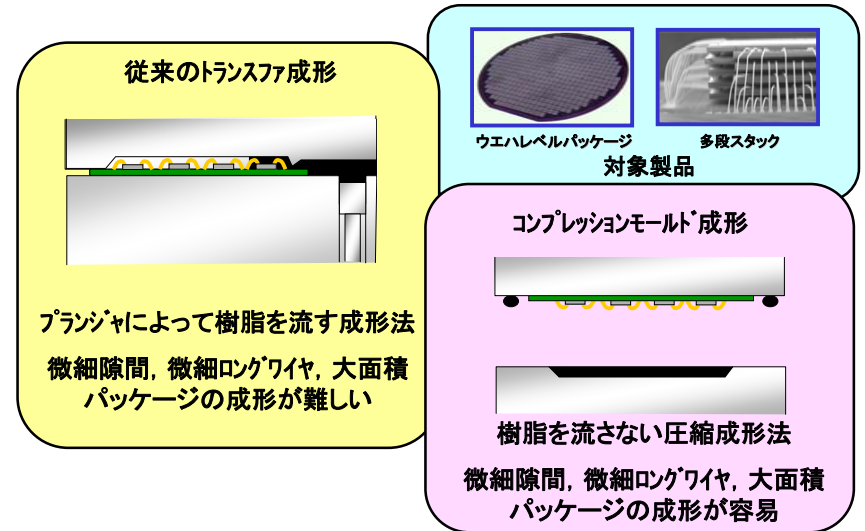
地域別受注高(連結)



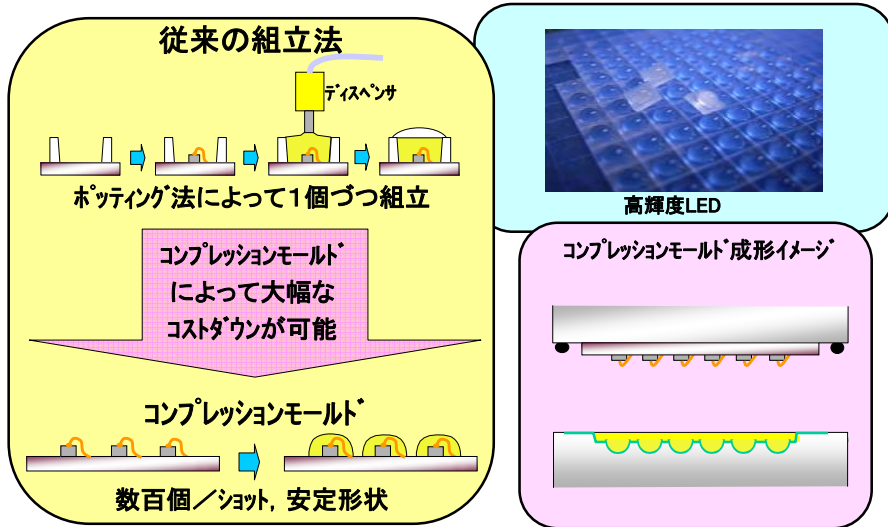
パッケージとモールド技術ロードマップ



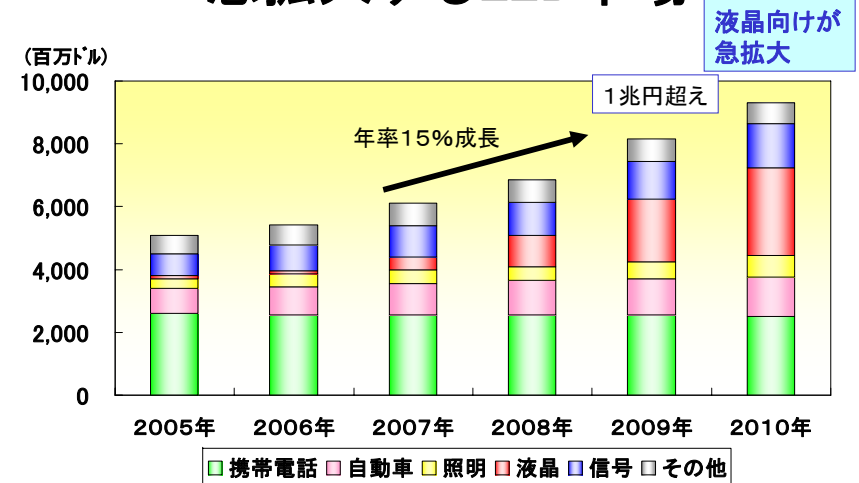
コンプレッションモールド(ICへの活用例)



コンプレッションモールドを適用した高輝度LED生産法

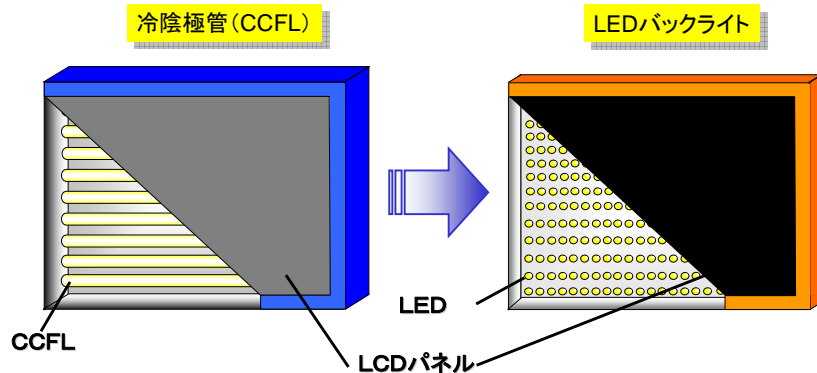


急拡大するLED市場



液晶パネル・バックライトの仕組み

冷陰極管 (CCFL) から LED バックライトへ



メリット: 薄型化、高輝度化、発光色の美しさ、環境に優しい

家電見本市「CEATEC JAPAN2007」

薄型ディスプレイ進化のトレンド

ローカルディミング

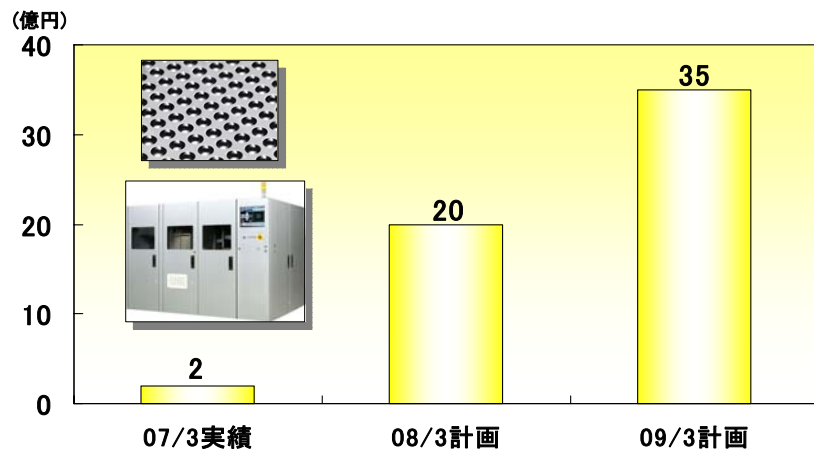
LEDの採用により、液晶TVの画質改善が新次元へ

液晶はコントラスト比が低い

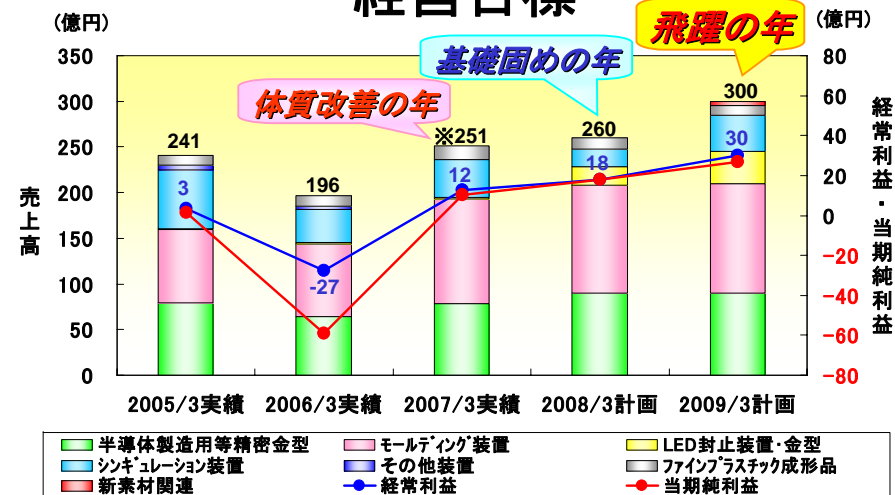


LEDバックライトでエリア制御を行ない、画面の明るい部分を発光させて、暗い部分を消し、コントラスト比を高める。

LED封止装置・金型 売上高推移



経営目標



※国内子会社2社の決算期変更に伴う売上高の増加6億円を含む

この資料についてのお問い合わせ

TOWA株式会社 経営企画室

〒601-8105 京都市南区上鳥羽上調子町5

Tel : 075-692-0251

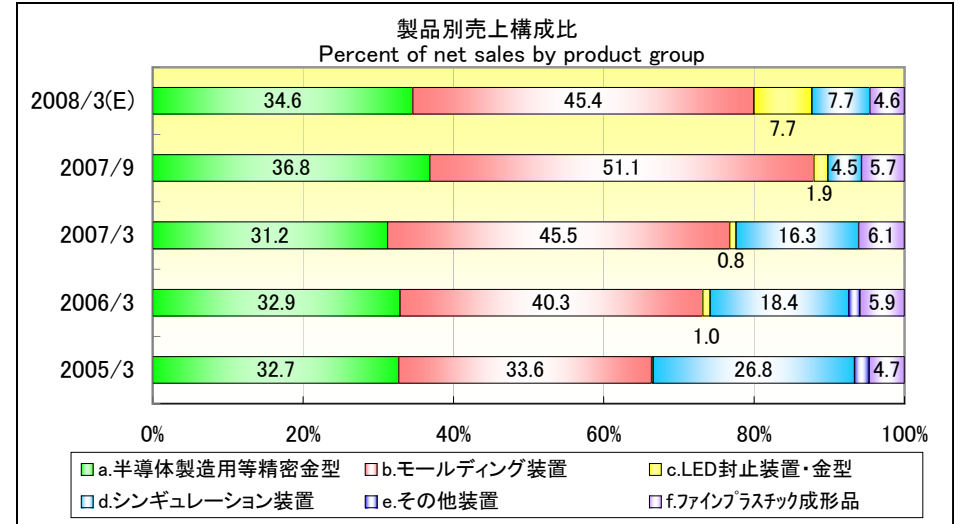
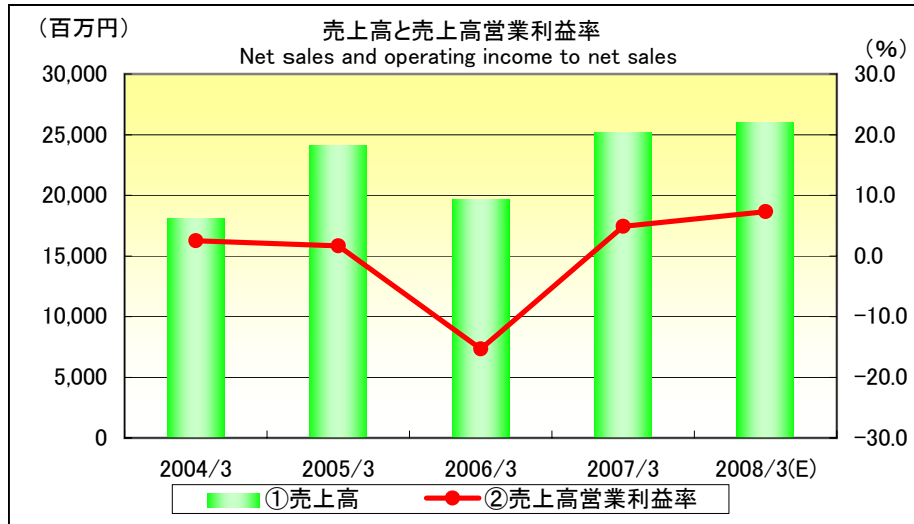
Fax: 075-692-0270

<http://www.towajapan.co.jp>

本資料おける予想は、現在入手可能な情報から得られた情報に基づいており、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。

実際の業績は、様々な要因により、これらの業績予想とは異なることがありますことをご承知おきください。

I. 決算概況(連結) Operating Results (Consolidated)



決算期		2004/3	2005/3	2006/3	2007/3	2008/3(E)
経営成績・財政状態	Operating results and financial conditions					
売上高	①Net sales	18,101	24,111	19,641	25,159	26,000
営業利益	Operating income	449	402	-3,012	1,224	1,900
経常利益	Ordinary income	335	326	-2,778	1,289	1,800
当期純利益	Net income	-2,615	146	-5,923	1,038	1,800
総資産	Total assets	35,560	38,343	36,602	34,925	—
純資産	Net assets	15,703	15,998	13,003	14,941	—
1株当たり指標	Per share data					
1株当たり当期純利益	Net income per share	-126.00	7.04	-275.58	41.59	71.96
諸指標	Data					
自己資本当期純利益率	Return on equity	-15.3	0.9	-40.8	7.4	11.4
総資産経常利益率	Ordinary income to total assets	0.9	0.9	-7.4	3.6	—
売上高営業利益率	②Operating income to net sales	2.5	1.7	-15.3	4.9	7.3
自己資本比率	Equity ratio	44.2	41.7	35.5	42.8	—

(単位:百万円/¥Millions)

	2006/9	2007/9
売上高	12,346	11,460
営業利益	559	803
経常利益	528	824
当期純利益	400	885
総資産	36,478	33,594
純資産	14,036	15,971
1株当たり当期純利益	16.05	35.41
自己資本当期純利益率	3.0	5.7
総資産経常利益率	1.4	2.4
売上高営業利益率	4.5	7.0
自己資本比率	38.5	47.5

増減率	Percent change	2004/3	2005/3	2006/3	2007/3	2008/3(E)
決算期						
売上高	Net sales	25.3	33.2	-18.5	28.1	3.3
営業利益	Operating income	—	-10.5	—	—	55.2
経常利益	Ordinary income	—	-2.7	—	—	39.6
当期純利益	Net income	—	—	—	—	73.3

	2006/9	2007/9
売上高	90.0	-7.2
営業利益	—	43.6
経常利益	—	56.0
当期純利益	—	121.5

※a.Precision molds

b.Semiconductor plastic encapsulation systems

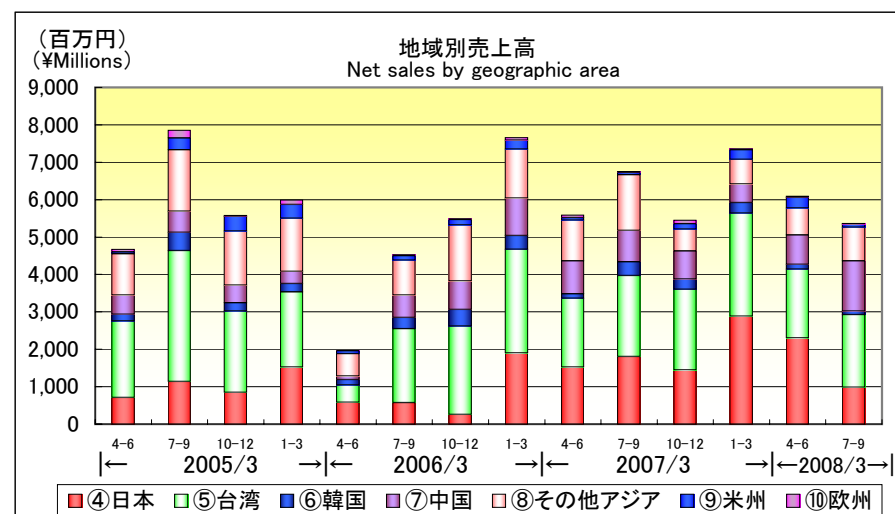
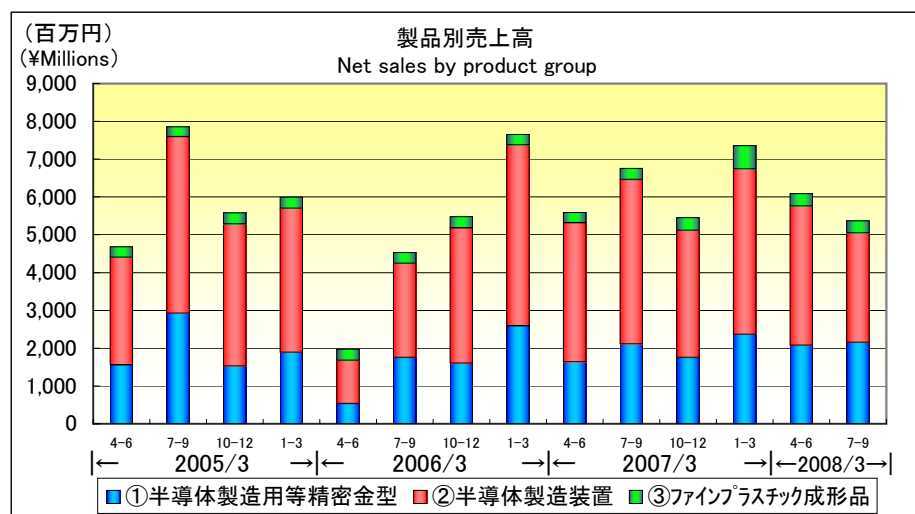
c.Semiconductor plastic encapsulation systems for LED

d.Signiture parts and systems

e.Others

f.Engineering plastic molded products

II. 四半期売上動向(連結) Quarterly Net Sales (Consolidated)



※ 従来半導体製造用等精密金型に分類していましたが、シンギュレーション金型部品を半導体製造装置に含めて表示しております。

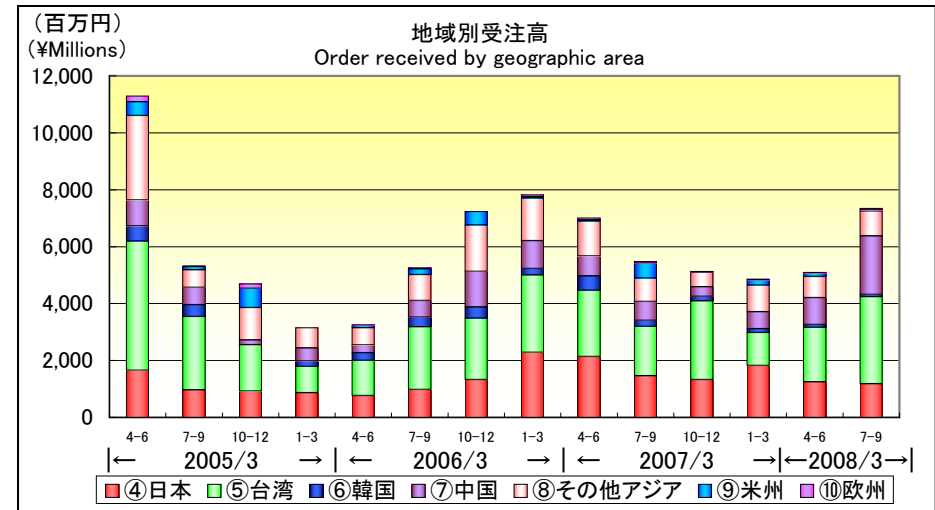
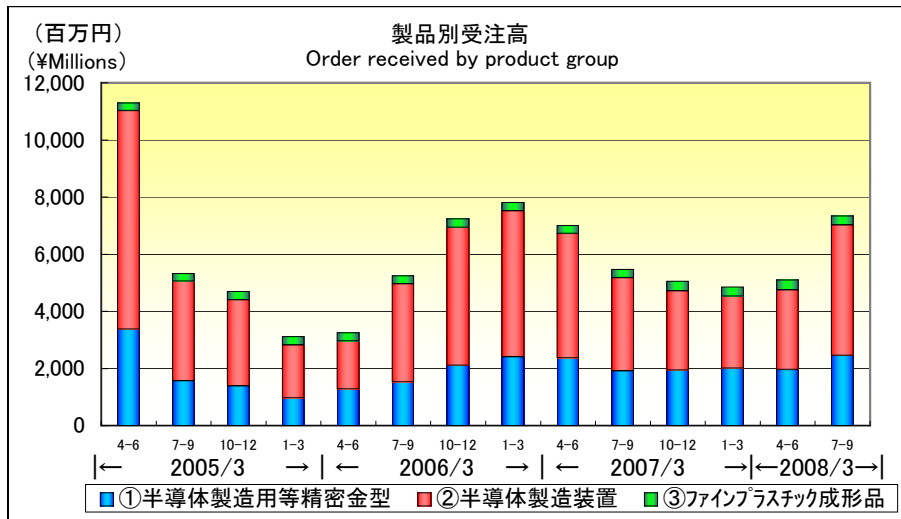
製品別売上高 Net sales by product group

決算期	2005/3					2006/3					2007/3					2008/3		
	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	上期
売上高合計 Total sales	4,678	7,859	5,578	5,994	24,111	1,970	4,528	5,483	7,659	19,641	5,589	6,756	5,451	7,362	25,159	6,090	5,369	11,460
半導体製造用等精密金型																		
①Precision molds	1,559	2,924	1,523	1,885	7,891	531	1,751	1,598	2,588	6,462	1,633	2,112	1,755	2,359	7,861	2,073	2,149	4,222
半導体製造装置																		
②Semiconductor manufacturing equipment	2,845	4,667	3,761	3,815	15,088	1,144	2,494	3,581	4,788	12,017	3,680	4,351	3,355	4,379	15,766	3,681	2,901	6,582
ファインプラスチック成形品																		
③Engineering plastic molded products	274	268	293	293	1,129	294	281	302	282	1,161	275	293	341	622	1,531	336	319	655
月平均	1,559	2,620	1,859	1,998	2,009	657	1,509	1,828	2,553	1,637	1,863	2,252	1,817	2,454	2,097	2,030	1,790	1,910

地域別売上高 Net sales by geographic area

決算期	2005/3					2006/3					2007/3					2008/3		
	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	上期
売上高合計 Total sales	4,678	7,859	5,578	5,994	24,111	1,970	4,528	5,483	7,659	19,641	5,589	6,756	5,451	7,362	25,159	6,090	5,369	11,460
日本 ④Japan	711	1,139	845	1,524	4,220	581	571	254	1,896	3,302	1,519	1,805	1,447	2,880	7,653	2,300	983	3,284
アジア太平洋 Asia pacific	3,839	6,199	4,315	3,983	18,336	1,302	3,814	5,069	5,458	15,644	3,927	4,858	3,762	4,192	16,742	3,477	4,283	7,760
(内 台湾) ⑤Taiwan	2,040	3,498	2,177	2,012	9,728	463	1,976	2,362	2,779	7,582	1,842	2,165	2,157	2,761	8,927	1,841	1,944	3,785
(内 韓国) ⑥Korea	181	485	224	222	1,113	143	300	450	368	1,262	117	366	272	283	1,040	131	89	220
(内 中国) ⑦China	514	567	470	321	1,873	97	604	762	1,001	2,465	884	840	751	493	2,969	781	1,350	2,132
(内 その他アジア) ⑧Other asia	1,102	1,647	1,443	1,426	5,620	597	933	1,494	1,309	4,333	1,084	1,486	580	654	3,805	722	899	1,622
米州 ⑨America	52	312	394	366	1,125	76	120	147	233	578	74	64	146	258	543	284	83	367
欧州 ⑩Europe	75	208	23	120	428	9	22	12	70	115	66	28	94	31	220	28	19	48

Ⅲ. 四半期受注動向(連結) Quarterly Order (Consolidated)



※ 従来半導体製造用等精密金型に分類していましたが、シンギュレーション金型部品を半導体製造装置に含めて表示しております。

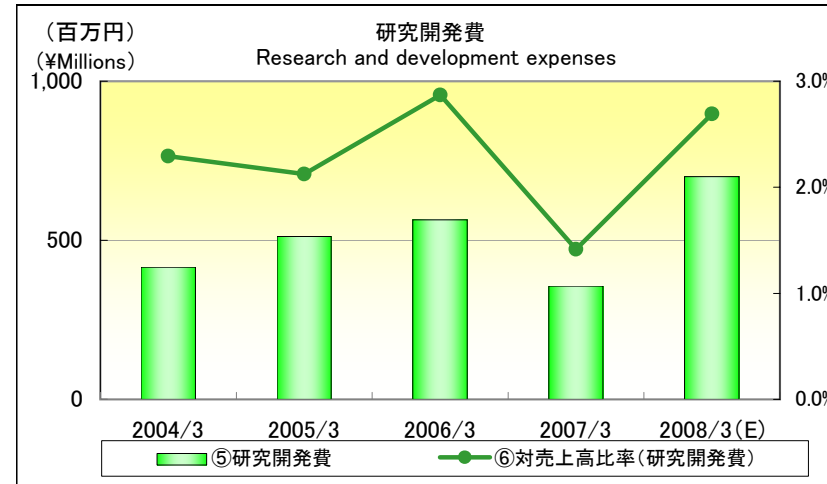
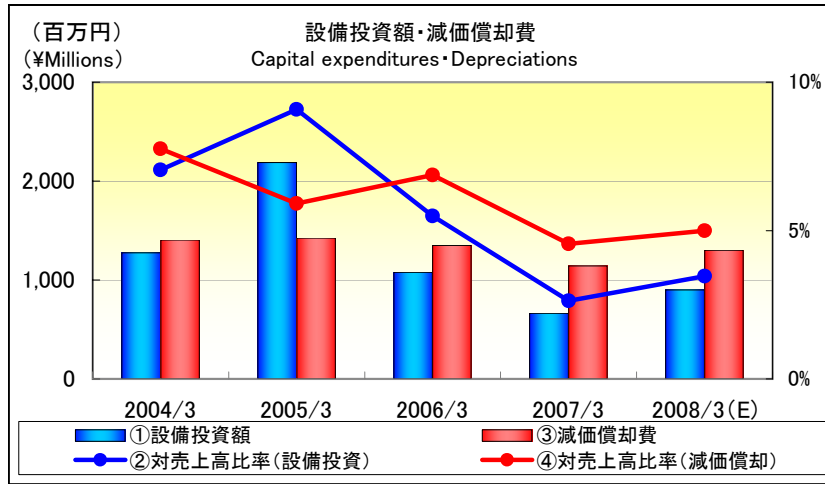
製品別受注高 Order received by product group

決算期	2005/3					2006/3					2007/3					2008/3		
	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	上期
受注高合計 Total order received	11,299	5,318	4,696	3,121	24,435	3,249	5,247	7,237	7,814	23,547	7,004	5,475	5,051	4,857	22,388	5,097	7,345	12,443
半導体製造用等精密金型 ① Precision molds	3,367	1,570	1,384	960	7,282	1,273	1,527	2,110	2,406	7,318	2,369	1,917	1,938	2,006	8,232	1,964	2,453	4,418
半導体製造装置 ② Semiconductor manufacturing equipment	7,653	3,485	3,016	1,863	16,018	1,685	3,442	4,828	5,110	15,068	4,359	3,254	2,783	2,516	12,915	2,790	4,573	7,364
ファインプラスチック成形品 ③ Engineering plastic molded products	278	263	295	297	1,134	290	276	297	295	1,161	275	302	328	333	1,241	342	318	661
月平均	3,766	1,773	1,565	1,040	2,036	1,083	1,749	2,412	2,605	1,962	2,335	1,825	1,684	1,619	1,866	1,699	2,448	2,074

地域別受注高 Order received by geographic area

決算期	2005/3					2006/3					2007/3					2008/3		
	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	上期
受注高合計 Total order received	11,299	5,318	4,696	3,121	24,435	3,249	5,247	7,237	7,814	23,547	7,004	5,475	5,051	4,857	22,388	5,097	7,345	12,443
日本 ④ Japan	1,650	969	927	871	4,418	763	982	1,331	2,283	5,361	2,133	1,465	1,322	1,821	6,742	1,249	1,176	2,425
アジア太平洋 Asia pacific	8,958	4,215	2,928	417	18,378	2,384	4,032	5,433	5,427	17,277	4,760	3,432	3,770	2,826	14,788	3,706	6,078	9,785
(内 台湾) ⑤ Taiwan	4,545	2,570	1,630	913	9,659	1,242	2,199	2,155	2,717	8,314	2,337	1,724	2,767	1,164	7,994	1,909	3,063	4,973
(内 韓国) ⑥ Korea	529	421	192	1,143	2,677	267	341	389	229	1,227	498	214	158	131	1,002	108	81	189
(内 中国) ⑦ China	908	609	160	463	2,142	267	578	1,251	975	3,072	698	671	345	600	2,316	935	2,054	2,989
(内 その他アジア) ⑧ Other asia	2,974	613	1,138	707	5,433	606	915	1,636	1,505	4,663	1,226	821	498	929	3,475	753	878	1,632
米州 ⑨ America	482	120	680	-16	1,266	92	203	464	38	799	49	528	-78	177	677	113	41	154
欧州 ⑩ Europe	208	13	160	-10	372	8	30	7	64	109	60	50	36	32	179	28	50	78

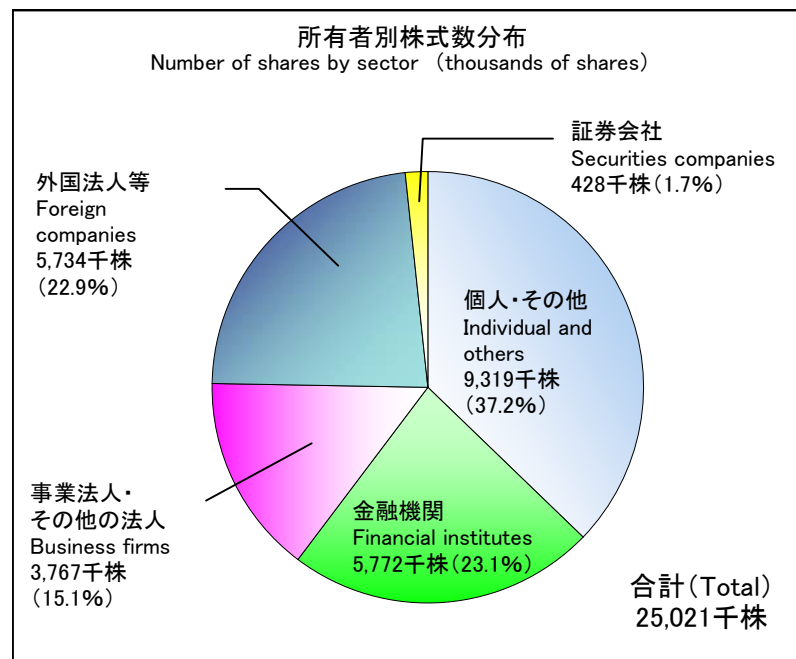
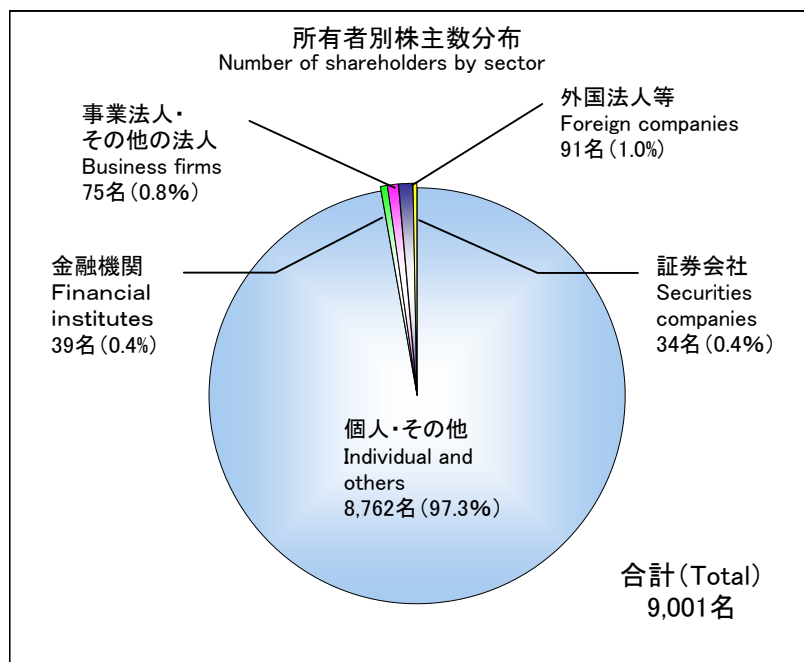
IV. キャッシュフロー、設備投資額、研究開発費(連結) Cash Flows and Capital Expenditures, Research and Development expenses (Consolidated)



(連結) (Consolidated)		2004/3	2005/3	2006/3	2007/3	2008/3(E)
決算期						
キャッシュフロー	Cash flows					
営業活動によるキャッシュフロー	Sales activities	581	-2,571	-166	1,894	—
投資活動によるキャッシュフロー	Investing activities	-1,319	-1,883	-1,548	252	—
財務活動によるキャッシュフロー	Financing activities	-179	3,947	2,232	-2,203	—
現金および現金同等物期末残高	Cash and cash equivalents at	3,479	2,959	3,588	3,542	—
設備投資額	①Capital expenditures	1,276	2,189	1,079	663	900
対売上比率	②Ratio of sales	7.05	9.08	5.49	2.64	3.46
減価償却費	③Depreciations	1,403	1,425	1,349	1,144	1,300
対売上比率	④Ratio of sales	7.75	5.91	6.87	4.55	5.00
研究開発費	⑤Research and development expenses	415	512	564	356	700
対売上比率	⑥Ratio of sales	2.30	2.12	2.87	1.42	2.69

(単位: 百万円/¥Millions)		2006/9	2007/9
		963	1,293
		-256	-623
		-455	-1,236
		3,813	2,970
		388	534
		3.14	4.66
		608	590
		4.92	5.15
		199	400
		1.61	3.49

V. 株式の状況 (2007年9月30日現在) State of Shares (September 30, 2007)



■大株主

Major Shareholders

株主名	Major Shareholders	当社への出資状況 Investment to the Company	
		所有株式数(千株) Thousands of shares	持株比率 Proportion
坂東和彦	Kazuhiko Bandoh	2,095	8.38%
(有)ケイビー恒産	K.B.Kosan Ltd.	2,000	7.99%
日本トラスティ・サービス信託銀行(株)	Japan Trustee Services Bank, Ltd.	1,952	7.80%
資産管理サービス信託銀行(株)	Trust & Custody Services Bank, Ltd.	1,097	4.39%
モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピー・エルシー	Morgan Stanley & Co. International Limited	936	3.74%
(株)京都銀行	The Bank of Kyoto, Ltd.	699	2.80%
ザ・チェース・マンハッタン・バンク・エヌ・エイ・ロンドン・エス・エル・オムニバス・アカウント	The Chase Manhattan Bank NA, London SL Omnibus Account	655	2.62%
バンク・オブ・ニューヨーク・ジーシー・エム・クライアント・アカウント・イー・アイ・エス・ジー	Bank of New York GCM Client Accounts EISG	620	2.48%
日本マスタートラスト信託銀行(株)	The Master Trust Bank of Japan, Ltd.	603	2.41%
ビー・エヌ・ピー・パリバ・セキュリティーズ・サービス・ルクセンブルグ・ジャスデック・セキュリティーズ	BNP Paribas Securities Services Luxembourg Jasdec Securities.	520	2.08%